

GP400

双组份导热凝胶

产品介绍

GF400 是一款双组份液体有机硅界面填充材料。该产品具有非常高的导热率（4W-mK）和柔软贴合性，能够在室温下固化，也可在较高温度下加速固化。

GF400 拥有良好的触变性，易于点涂。低粘度配方设计尤其适用于低压力装配的应用中。固化后该材料会形成低模量的弹性体并降低由于热膨胀系数差异所产生的应力挤压作用，从而有效防止 pump-out 现象发生。

特点

- * 良好的柔软贴合性使其适用于低压力装配应用
- * 极高的导热率：4.0 W/m-K
- * 优异的触变性能，易于点胶
- * 可室温固化或高温快速固化

应用

- * 汽车电子设备
- * 移动电子设备
- * 通信基站
- * 显卡
- * LED 灯
- * 微处理器及芯片

性能

颜色/A 组份: 粉色

颜色/B 组份:	白色
密度 @ 20°C:	3.2g/cm ³
混合比例:	1:1
粘度 @Brookfield (Part A):	170,000cps
粘度 @Brookfield (Part B):	170,000cps

固化后性能

颜色:	粉色
硬度:	40 shore00
导热系数:	4.0 W/mK
温度范围:	-50°C ~ +200°C
阻燃等级:	UL-94V0

固化时间

操作时间 @ 25°C:	60 min
固化时间 @ 25°C:	12 hrs
固化时间 @ 100°C:	20 min

储存

5°C - 35°C 温度条件下储存，最大相对湿度不超过 50%。